

# 國立金門大學 電機工程學系碩士班 課程規劃表

本學系碩士生畢業時至少應修滿 30 學分，包括

113 學年度入學新生適用  
修訂歷程

專業必修：6 學分

113年3月07日112學年度第二學期第一次系課程規劃委員會訂定通過  
113年4月10日112學年度第二學期第一次院課程規劃委員會訂定通過  
113年0月00日112學年度第二學期第1次校級課程規畫委員會訂定通過

專業選修：24 學分

	一年級	上學期		下學期		二年級	上學期		下學期		二年合計	
		學分	時數	學分	時數		學分	時數	學分	時數		
<b>共同必修</b>	校園學術倫理數位課程	0	1									
<b>總計</b>		0	0				0	0			0	
<b>專業必修</b>	專題討論(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)											
						學位論文				6		
<b>總計</b>		0	0				0	6			6	
<b>專業選修</b>	研究基礎領域	科學計算	3	3			校外實習(一)	0	1			
							校外實習(二)			0	1	
	通訊與系統應用領域	數位影像處理	3	3			展頻通訊	3	3			
		鎖相迴路設計與應用	3	3			高等計算機結構	3	3			
		高等電力系統	3	3			嵌入式行動機器人	3	3			
		深度學習概論	3	3								
		數位信號處理			3	3						
		行動通訊系統			3	3						
		編碼理論			3	3						
		模糊系統			3	3						
		智慧型計算			3	3						
		電力電子實務			3	3						
		深度學習			3	3						
		太陽能電力系統			3	3						
	固態與積體電路領域	薄膜工程	3	3			表面分析技術	3	3			
		能量轉換原理	3	3			智慧控制	3	3			
		射頻積體電路與模擬	3	3			奈米工程			3	3	
		模式化通訊IC設計	3	3								
		半導體製程技術	3	3								
		新能源技術	3	3								
		射頻無線系統與應用	3	3								
		超大型積體電路設計			3	3						
		表面工程			3	3						
		半導體量測技術			3	3						
太陽能技術				3	3							
通訊網路積體電路設計				3	3							
高頻電路佈局與模擬			3	3								
類比積體電路設計與模擬			3	3								
半導體元件及物理			3	3								
<b>總計</b>		36	48				15	3			102	
<b>學期總計</b>		36	48				15	9				

**備註：**

- 一、畢業總學分30學分，學位論文6學分，專業選修24學分(包含6學分可選修非本系所開設之課程)，必須滿足本學系修讀規定。
- 二、「專題討論(一)~(八)」為在學其修業期間每學期必修0學分1小時之課程。
- 三、專業選修課程不分年級。
- 四、碩班課程皆與學士班四年級合開。
- 五、表列選修科目為預定科目，將視實際需要而調整。
- 六、專題討論(一)及(二)以指導教授參與的專長組別為主。
- 七、「專題討論(五)~(八)」得抵修任一學期「專題討論(一)~(四)」
- 八、研究生須於申請學位考試當學期修得學位論文。